

2008年度第2四半期 決算説明会

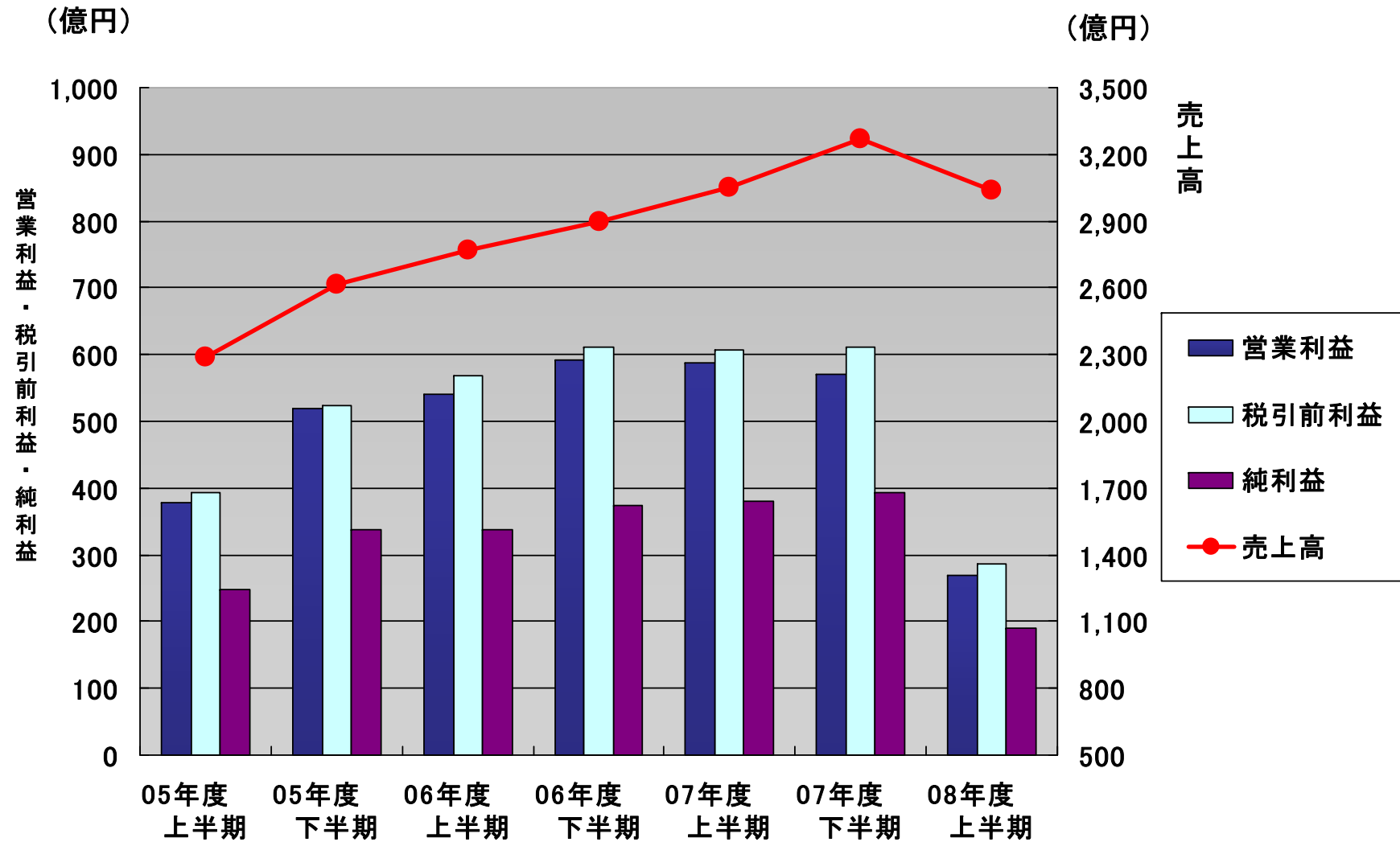
2008年10月31日
株式会社村田製作所



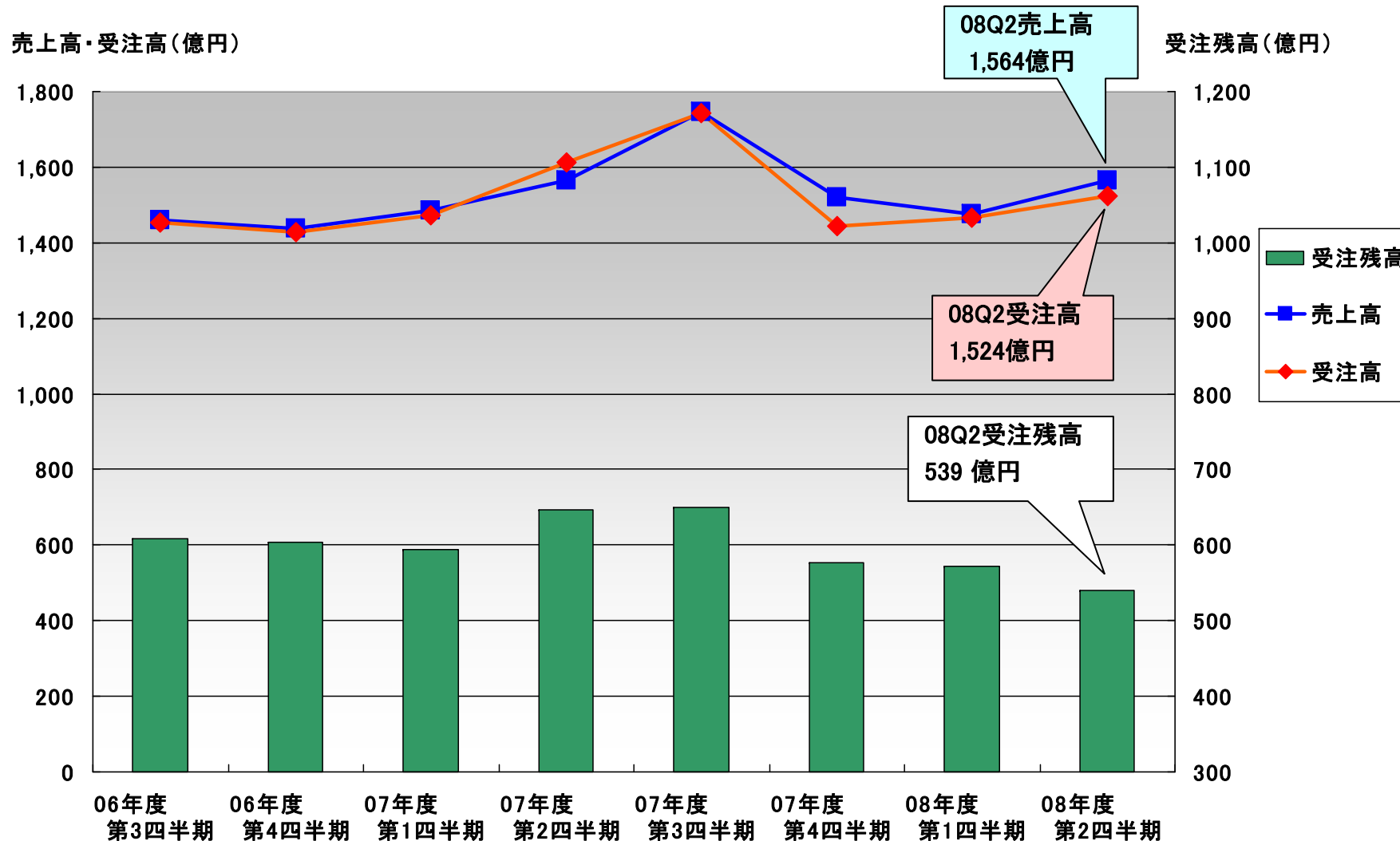
1. 2008年度 第2四半期業績概要

**2008年4月～2008年9月
第2四半期連結累計期間**

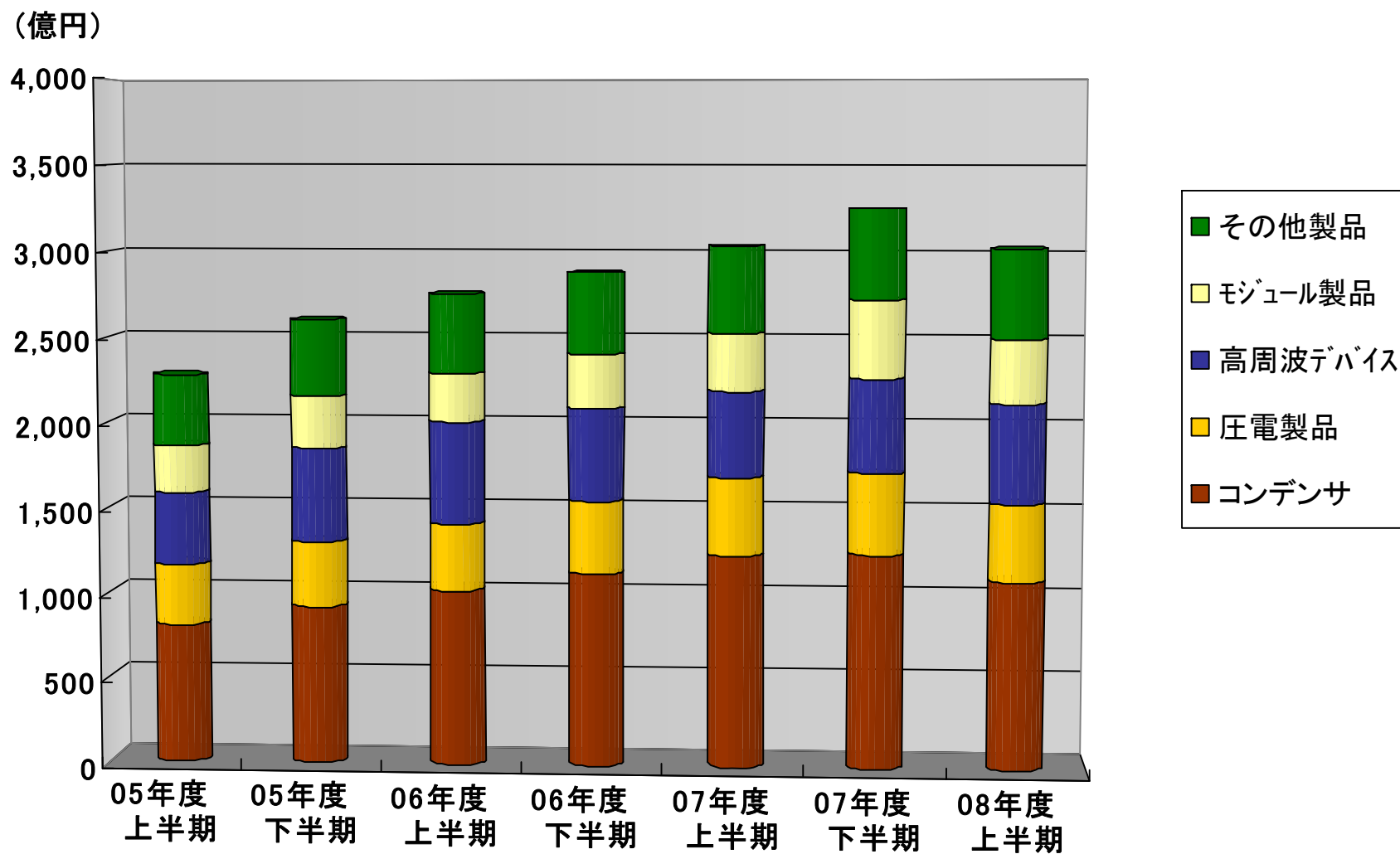
当上半期の業績概要



四半期の売上・受注・注残推移



製品別売上高推移



製品別売上高

	2007年度 上半期		2008年度 上半期		増減	
	(億円)	(%)	(億円)	(%)	(億円)	(%)
コンデンサ	1,242	40.9	1,100	36.3	▲142	▲11.4
圧電製品	453	14.9	449	14.8	▲4	▲0.9
高周波デバイス	504	16.6	583	19.3	+79	+15.7
モジュール製品	333	10.9	373	12.3	+40	+12.1
その他製品	508	16.7	523	17.3	+15	+3.0
製品売上高計	3,039	100.0	3,028	100.0	▲11	▲0.4

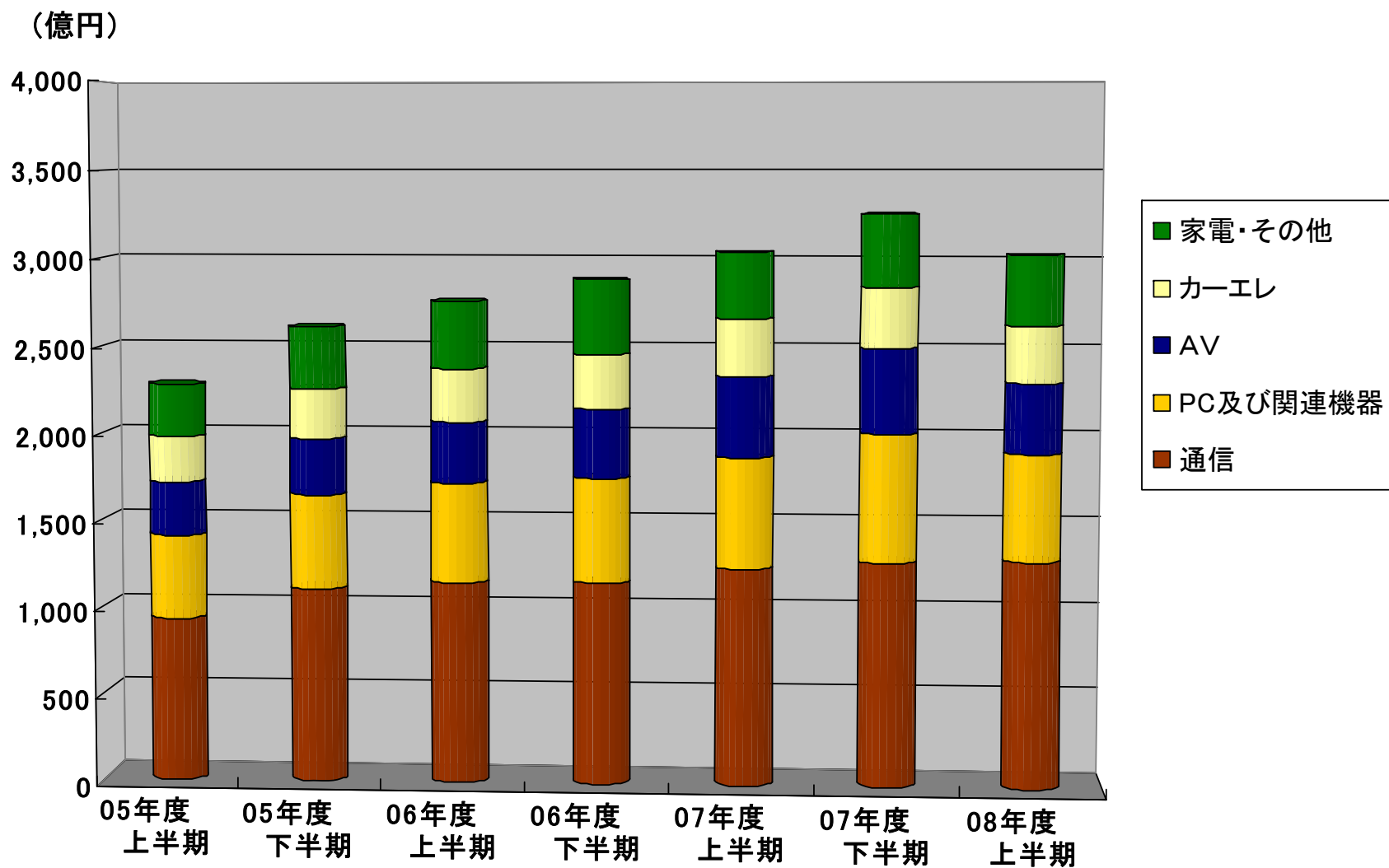
製品別売上高

<p>コンデンサ (前年同期比▲11.4%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・チップ積層セラミックコンデンサ: 大容量品が大幅に減少 ・用途特化型品: PC及び関連機器向けに大幅に減少
<p>圧電製品 (前年同期比▲0.9%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・表面波フィルタ: 通信機器向けに減少 ・圧電ブザー: AV機器向けに大幅に伸長 ・圧電センサ: HDD向けに大幅に増加 ・セラミック発振子: PC及び関連機器向けやカーエレ向けに大きく減少 ・セラミックフィルタ: 通信機器向けやカーエレ向けに大幅に減少
<p>高周波デバイス (前年同期比+15.7%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・近距離無線通信モジュール: Bluetooth®モジュールが減少したものの、無線LANモジュールが大幅に伸長しトータルで大きく増加 ・多層デバイス、アイソレータ: 通信機器向けに増加
<p>モジュール製品 (前年同期比+12.1%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・電源: MPSの売上計上(07年3Qより連結) ・回路モジュール: 通信機器用モジュールが減少、携帯電話用の地上デジタルチューナが大幅に増加
<p>その他製品 (前年同期比+3.0%)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・EMI除去フィルタ: 通信機器向けに増加 ・チップコイル: 通信機器向けに大きく伸長 ・ジャイロセンサ: AV機器向けに大きく減少

(注) Bluetoothは米国Bluetooth SIG, Inc.の商標です

(注) MPS: Murata Power Solutions (07年8月米国C&Dテクノロジーズ社より買収したPower Electronics 事業部)

用途別売上高推移



用途別売上高

	2007年度 上半期		2008年度 上半期		増減	
	(億円)	(%)	(億円)	(%)	(億円)	(%)
AV	459	15.1	398	13.2	▲61	▲13.2
通信	1,241	40.8	1,294	42.8	+54	+4.3
PC及び関連機器	635	20.9	613	20.2	▲22	▲3.5
カーエレ	331	10.9	325	10.7	▲6	▲1.8
家電・その他	374	12.3	398	13.1	+24	+6.4
製品売上高計	3,039	100.0	3,028	100.0	▲11	▲0.4

用途別売上高

AV機器 (前年同期比▲13.2%)	・ゲーム機向け、薄型テレビ向け、DSC向けが大幅に減少
通信 (前年同期比+4.3%)	・第3世代機向けに無線LANモジュール、チップコイル、地上デジタルチューナ等が増加
PC及び関連機器 (前年同期比▲3.5%)	・サーバー・産業用機器向けでMPS売上が寄与 ・HDD向け、コピー機向けが増加 ・MPU向け、プリンタ向けが大幅に減少
カーエレ (前年同期比▲1.8%)	・カーナビ向け、ソナー向けが増加 ・カーオーディオ向け、RKE向けが減少

※RKE:リモート・キーレス・エントリー

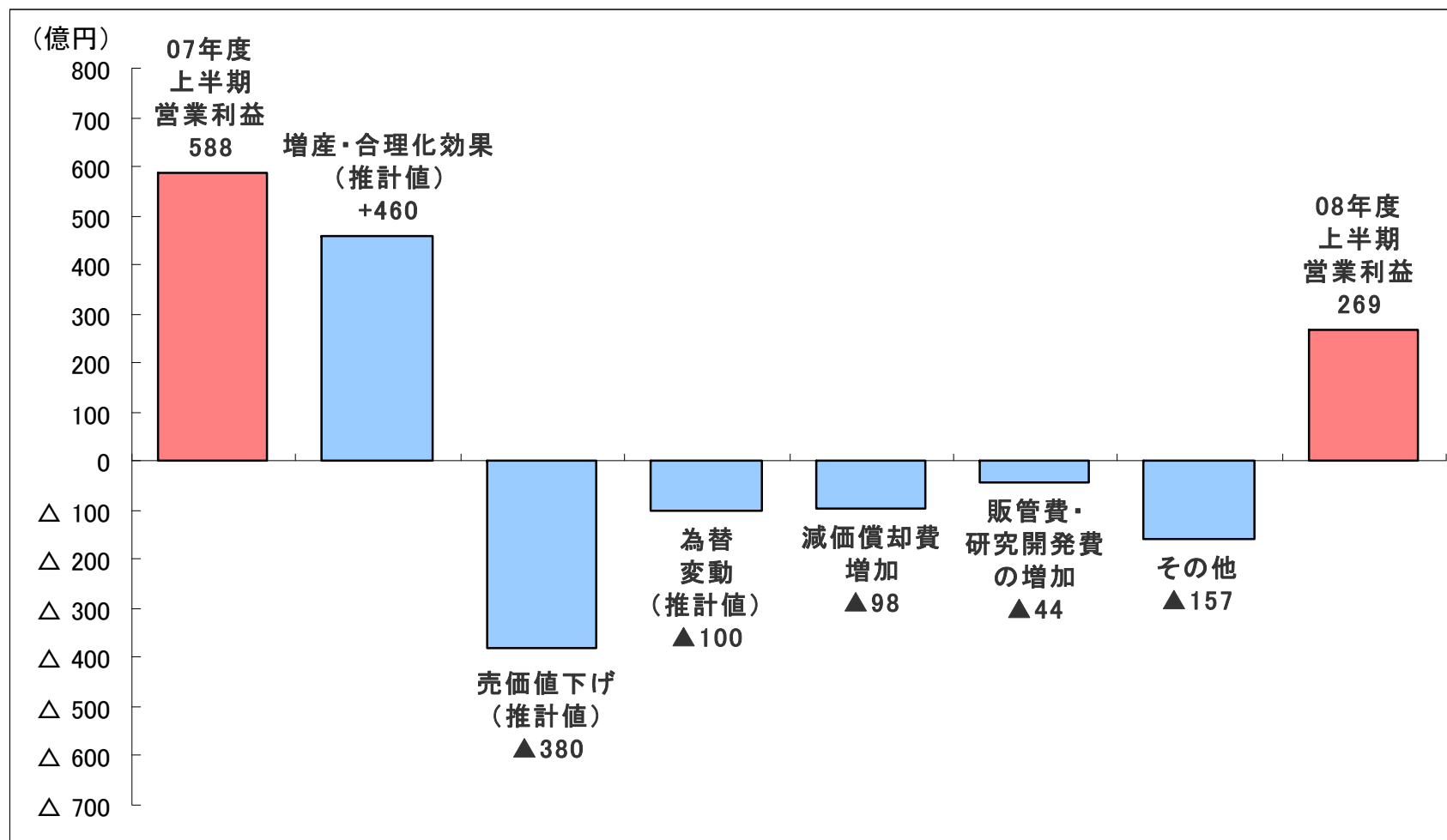
業績概況

	2007年度 上半期		2008年度 上半期		増減	
	(億円)	(%)	(億円)	(%)	(億円)	(%)
売上高	3,049	100.0	3,040	100.0	▲10	▲0.3
営業利益	588	19.3	269	8.9	▲318	▲54.2
税引前利益	607	19.9	287	9.5	▲320	▲52.7
純利益	380	12.4	190	6.3	▲189	▲49.8

(参考)

減価償却費	288	9.4	385	12.7	+98	+34.0
償却前営業利益	875	28.7	655	21.5	▲221	▲25.2

2008年度上半期営業利益変動要因



四半期の業績推移

	2008年度 第1四半期		2008年度 第2四半期		増減	
	(億円)	(%)	(億円)	(%)	(億円)	(%)
売上高	1,476	100.0	1,564	100.0	+88	+5.9
営業利益	146	9.9	124	7.9	▲22	▲15.0
税引前利益	151	10.2	137	8.7	▲14	▲9.5
純利益	96	6.5	94	6.0	▲2	▲1.6

(参考)

減価償却費	186	12.6	199	12.7	+13	+7.1
償却前営業利益	332	22.5	323	20.7	▲9	▲2.6

2. 2008年度 業績予想

(2008年4月～2009年3月)

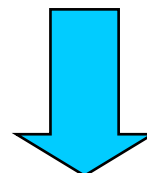
部品需要予測

携帯電話

11.7億台(2007年度) → 12.2億台(2008年度)

08/4予想	2007年度			2008年度前提			(億台) 通期 伸率
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	
部品需要台数	5.6	6.0	11.6	6.1	6.3	12.3	7%

(※当社推定値)



今回予想	2007年度			2008年度前提			(億台) 通期 伸率
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	
部品需要台数	5.6	6.1	11.7	6.1	6.1	12.2	4%

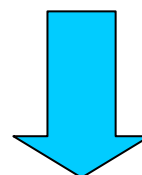
(※当社推定値)

部品需要予測

PC
2.8億台(2007年度) → 2.9億台(2008年度)

08/4予想	2007年度			2008年度前提			(億台)
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	通期伸率
部品需要台数	1.4	1.3	2.8	1.4	1.5	2.9	6%

(※当社推定値)



今回予想	2007年度			2008年度前提			(億台)
	上期	下期	通期	上期	下期	通期	通期伸率
部品需要台数	1.4	1.3	2.8	1.4	1.4	2.9	5%

(※当社推定値)

2008年度の業績予想

	前回予想 (08/7)				今回予想			
	2008年度				2008年度			
	上期予想	下期予想	通期予想		上期実績	下期予想	通期予想	
	(億円)	(億円)	(億円)	(%)	(億円)	(億円)	(億円)	(%)
売上高	3,100	3,300	6,400	+1.3	3,040	3,010	6,050	▲4.2
営業利益	310	390	700	▲39.5	269	131	400	▲65.5
税引前利益	325	425	750	▲38.4	287	173	460	▲62.2
純利益	205	260	465	▲39.9	190	110	300	▲61.2

(参考)

減価償却費	385	415	800	+22.8	385	415	800	+22.8
償却前営業利益	695	805	1,500	▲17.1	655	545	1,200	▲33.1

※(%)は前期比伸び率

用途別売上予想

	2008年度通期予想(前期比)		2008年度 上期実績 (前年同期比)	2008年度 下期予想 (上期比)
	今回予想	前回予想 (08/7)		
AV	▲15%程度	▲3%程度	▲13.2%	横ばい
通信 計 (うち携帯電話)	+2%程度 (+4%程度)	+7%程度 (+8%程度)	+4.3% (+5.2%)	▲2%程度 (▲2%程度)
PC及び関連機器	▲10%程度	▲3%程度	▲3.5%	横ばい
カーエレ	▲3%程度	+3%程度	▲1.8%	横ばい
家電・その他	▲2%程度	▲5%程度	+6.4%	▲5%程度

製品別売上予想

	2008年度通期予想(前期比)		2008年度	2008年度
	今回予想	前回予想 (08/7)	上期実績 (前年同期比)	下期予想 (上期比)
コンデンサ	▲13%程度	▲5%程度	▲11.4%	▲5%程度
圧電製品	▲3%程度	+5%程度	▲0.9%	微減
高周波デバイス	+13%程度	+15%程度	+15.7%	+3%程度
モジュール (MPS除く)	▲5%程度 (▲12%程度)	▲3%程度 (▲10%程度)	+12.1% (▲11.0%)	横ばい (横ばい)
その他	+2%程度	+3%程度	+3.0%	横ばい

業績予想の前提

	2008年度 上期実績	2008年度 下期予想	2008年度 通期予想
減価償却費	385億円	415億円	800億円
研究開発費	236億円	234億円	470億円
設備投資額	430億円	320億円	750億円
為替レート(US\$)	106.11円/US\$	100.00円/US\$	

業績予想(利益の増減要因)

	2008年度上期 実績		2008年度下期 予想		増減	
	(億円)	(%)	(億円)	(%)	(億円)	(%)
売上高	3,040	100.0	3,010	100.0	▲ 30	▲ 1.0
営業利益	269	8.9	131	4.3	▲ 138	▲ 51.4
税引前利益	287	9.5	173	5.7	▲ 114	▲ 39.8
純利益	190	6.3	110	3.6	▲ 80	▲ 42.2

(参考)

減価償却費	385	12.7	415	13.8	+30	+7.7
償却前営業利益	655	21.5	545	18.1	▲ 110	▲ 16.8

利益変動要因

(※当社推定値)

・増産・合理化効果	+160億円
・上期一括費用	+37億円
・一般管理販売費用・研究開発費の減少	+5億円
・売価値下げ	▲200億円
・対ドル円高(106.11円/US\$→100.00円/US\$)	▲47億円
・減価償却費の増加	▲30億円
・その他品種構成差等	▲63億円

2008年度(09年3月期)の配当(予定)
1株当たり年間100円(うち中間配当50円)

2007年度の配当実績
1株当たり年間100円(うち中間配当50円)

※当配当は現時点での事業環境予測及び業績予想に基づくものであります。

自己株式取得

2008年10月30日の取締役会において自己株式取得の決議

- ・取得株式数: 550万株(発行済株式の2.5%)
- ・取得金額: 150億円
- ・取得期間: 2008年11月1日~12月22日

当資料に記載されている、当社又は当社グループに関する見通し、計画、方針、戦略、予定、判断などのうち既に確定した事実でない記載は、将来の業績に関する見通しです。将来の業績の見通しは、現時点で入手可能な情報と合理的と判断する一定の前提に基づき当社グループが予測したものです。実際の業績は、さまざまなリスク要因や不確実な要素により業績見通しと大きく異なる可能性があり、これらの業績見通しに過度に依存しないようお願いいたします。また、新たな情報、将来の現象、その他の結果に関わらず、当社が業績見通しを常に見直すとは限りません。実際の業績に影響を与えるリスク要因や不確実な要素には、以下のものが含まれます。(1)当社の事業を取り巻く経済情勢、電子機器及び電子部品の市場動向、需給環境、価格変動、(2)原材料等の価格変動及び供給不足、(3)為替レートの変動、(4)変化の激しい電子部品市場の技術革新に対応できる新製品を安定的に提供し、顧客が満足できる製品やサービスを当社グループが設計、開発し続けていく能力、(5)当社グループが保有する金融資産の時価の変動、(6)各国における法規制、諸制度及び社会情勢などの当社グループの事業運営に係る環境の急激な変化、(7)偶発事象の発生、などです。ただし、業績に影響を与える要素はこれらに限定されるものではありません。

当資料に記載されている将来予想に関する記述についてこれらの内容を更新し公表する責任を負いません。